

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013 年 3 月 14 日(14.03.2013)



(10) 国際公開番号

WO 2013/035685 A1

- (51) 国際特許分類:
C08L 63/00 (2006.01) C08K 5/1515 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01) C08K 9/02 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/072441
- (22) 国際出願日: 2012 年 9 月 4 日(04.09.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-193136 2011 年 9 月 5 日(05.09.2011) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ナミックス株式会社 (NAMICS CORPORATION) [JP/JP]; 〒9503131 新潟県新潟市北区濁川 3 9 9 3 番地 Niigata (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 水村 宜司 (MIZUMURA, Noritsuka). 山口 喬 (YAMAGUCHI, Takashi). 長柄 陽子 (NAGARA, Yoko).
- (74) 代理人: 特許業務法人 津国, 外 (TSUKUNI & ASSOCIATES et al.); 〒1000013 東京都千代田区霞が関 3-7-1 霞が関東急ビル Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: CONDUCTIVE RESIN COMPOSITION AND CURED OBJECT USING SAME

(54) 発明の名称: 導電性樹脂組成物及びそれを使用した硬化体

(57) Abstract: Provided is a conductive resin composition with which an increase in facility cost can be prevented in that solvent distillation and exposure to light are unnecessary; B staging (semicuring) is possible such that the product is sufficiently tack-free at relatively low temperatures while having excellent pressure-sensitive tack in that temporary adhesion of parts is possible; and a cured object having sufficient adhesive strength while retaining relatively low resistivity can be obtained by curing (C staging). Also provided is a cured object that uses the conductive resin composition. The conductive resin composition that is used for the cured object comprises (A) an epoxy resin, (B) a compound having (meth)acryloyl groups and glycidyl groups, (C) a phenol resin curing agent, (D) a radical polymerization initiator, and (E) conductive particles.

(57) 要約: 溶剤の留去や光照射を行うことなく、設備コストの増大を抑制し、比較的低温度で十分なタックフリーを有し、かつ部品を仮接着することができる優れた感圧タック性を有するようにBステージ化(半硬化)することができ、その後に硬化(Cステージ化)させて低い比抵抗値を維持しつつ、十分な接着強度を有する硬化体を得ることができる導電性樹脂組成物及びそれを使用した硬化体を提供する。(A)エポキシ樹脂、(B)(メタ)アクリロイル基及びグリシジル基を有する化合物、(C)フェノール樹脂系硬化剤、(D)ラジカル重合開始剤、並びに(E)導電性粒子を含有する導電性樹脂組成物及びそれを使用した硬化体である。

WO 2013/035685 A1